



平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年4月27日
上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長

(氏名) 東 哲郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員

(氏名) 原田 芳輝

TEL 03-5561-7000

定時株主総会開催予定日 平成27年6月19日

配当支払開始予定日

平成27年5月29日

有価証券報告書提出予定日 平成27年6月19日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期の連結業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期	613,124	0.2	88,113	173.6	92,949	161.9	71,888	—
26年3月期	612,170	23.1	32,204	156.6	35,487	112.5	△19,408	—

(注) 包括利益 27年3月期 80,295百万円 (—%) 26年3月期 △10,888百万円 (—%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	自己資本当期純利益 率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
27年3月期	401.08	400.15	11.8	10.9	14.4
26年3月期	△108.31	—	△3.3	4.4	5.3

(参考) 持分法投資損益 27年3月期 250百万円 26年3月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期	876,153	641,162	73.0	3,567.23
26年3月期	828,591	590,613	69.8	3,225.92

(参考) 自己資本 27年3月期 639,483百万円 26年3月期 578,091百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
27年3月期	71,806	155,737	△18,213	317,632
26年3月期	44,449	△19,599	△186	104,797

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
26年3月期	—	25.00	—	25.00	50.00	8,959	—	1.5
27年3月期	10.00	30.00	35.00	68.00	143.00	25,633	35.7	4.2
28年3月期(予想)	—	65.00	—	90.00	155.00		35.2	

(注)平成27年3月期の配当予想につきましては、本日公表の「平成27年3月期配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり当期 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%		
第2四半期(累計)	320,000	8.7	47,000	56.1	47,000	47.9	33,000	64.9
通期	675,000	10.1	112,000	27.1	112,000	20.5	79,000	9.9

円 銭

184.08

440.69

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	27年3月期	180,610,911 株	26年3月期	180,610,911 株
② 期末自己株式数	27年3月期	1,344,892 株	26年3月期	1,408,950 株
③ 期中平均株式数	27年3月期	179,238,551 株	26年3月期	179,192,909 株

(参考)個別業績の概要

平成27年3月期の個別業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期	555,092	20.1	47,094	190.2	86,502	210.7	63,267	—
26年3月期	462,282	23.1	16,230	183.9	27,839	1.9	△26,420	—

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
27年3月期	352.98	352.16
26年3月期	△147.44	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
27年3月期	671,759		405,468	60.1			2,253.90	
26年3月期	608,206		356,701	58.4			1,981.33	

(参考) 自己資本 27年3月期 404,047百万円 26年3月期 355,057百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信開示時点においては、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページをご覧ください。
 ・当社は、平成27年4月27日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 経営成績	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	6
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	7
2. 経営方針	8
(1) 会社の経営の基本方針	8
(2) 会社の対処すべき課題	8
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	10
4. 連結財務諸表	11
(1) 連結貸借対照表	11
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	13
(3) 連結株主資本等変動計算書	15
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	17
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	18
(継続企業の前提に関する注記)	18
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	18
(セグメント情報)	18
(1株当たり情報)	20
(重要な後発事象)	20
5. その他	21
(1) 生産、受注及び販売の状況	21

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の事業環境

当連結会計年度の世界経済につきましては、アジアの一部新興国において成長スピードの鈍化がみられましたが、米国を中心に緩やかな回復基調が続きました。また、日本経済においても、経済・金融政策の効果などを背景に、景気は緩やかな回復を示しております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業においては、新型の高機能スマートフォンの販売が好調であり、中国をはじめとする新興国のスマートフォン市場の拡大もみられました。また、モバイル端末の性能向上による通信量の増加やクラウドサービスの発展等に伴い、データセンター向けサーバー需要が伸びるなど、電子部品市場は堅調に推移いたしました。

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は6,131億2千4百万円(前連結会計年度比0.2%増)となりました。国内売上高が950億4千5百万円(前連結会計年度比41.2%減)、海外売上高が5,180億7千8百万円(前連結会計年度比15.0%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては84.5%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は6,609億6千7百万円(前連結会計年度比5.1%減)となり、当連結会計年度末の受注残高は2,957億7千1百万円(前連結会計年度末比11.6%増)となりました。

売上原価は3,703億5千1百万円(前連結会計年度比9.7%減)、売上総利益は2,427億7千3百万円(前連結会計年度比20.2%増)となり、売上総利益率は39.6%(前連結会計年度比6.6ポイント増)となりました。

販売費及び一般管理費は1,546億6千万円(前連結会計年度比8.9%減)となり、連結売上高に対する比率は25.2%(前連結会計年度比2.5ポイント減)となりました。

これらの結果、営業利益は881億1千3百万円(前連結会計年度比173.6%増)となりました。経常利益は、営業外収益49億8千5百万円、営業外費用1億4千9百万円を加減し929億4千9百万円(前連結会計年度比161.9%増)となりました。

特別損益に関しましては、61億2千1百万円の損失(前連結会計年度は472億4千3百万円の損失)となりました。

税金等調整前当期純利益は868億2千7百万円(前連結会計年度は117億5千6百万円の損失)、当期純利益は718億8千8百万円(前連結会計年度は194億8百万円の損失)となりました。

この結果、1株当たり当期純利益は401円8銭(前連結会計年度の1株当たり当期純損失は108円31銭)となりました。

③ 当連結会計年度のセグメント別営業概況

セグメント別の概況は以下のとおりです。

なお、当社は平成26年4月及び5月に東京エレクトロン デバイス(株)の一部を売却いたしました。これにより、当社が当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ異動し、当連結会計年度から、同社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外しました。上述の連結売上高の前年同期比増減率(0.2%増)につきましては、同社を連結の範囲から除外した影響が反映されたものであります。

《半導体製造装置》

好調なスマートフォンの販売やデータセンター向けサーバーの需要拡大、また、モバイル端末の高性能化に伴う端末当たりの半導体搭載量の増加等により、DRAMやNANDフラッシュメモリー等の電子部品需要は旺盛で、メモリーメーカーの増産投資が継続しております。また、ロジック系半導体につきましても、好調なサーバー需要やパソコンの買い替え需要に支えられ、設備投資は底堅く推移いたしました。このような状況のもと、当セグメントの当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は、5,762億4千2百万円(前連結会計年度比20.3%増)となりました。

なお、当セグメントにおきましては当連結会計年度に高生産性型スクラバー洗浄装置「NS300Z」、MRAM等の次世代半導体向けスパッタリング装置「EXIMTM」、高生産性型ドライクリーニング装置「Certas LEAGATM」などの新製品を市場に投入いたしました。

《FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置》

中国における大型液晶パネル向け設備投資に加え、モバイル端末向けの中小型液晶パネル需要も伸長し、FPD製造装置市場は堅調に推移いたしました。このような状況のもと、当セグメントの当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は、327億9百万円(前連結会計年度比15.5%増)となりました。

《PV(太陽光パネル)製造装置》

太陽光パネル製造装置の新規販売活動の撤退を決定しておりますが、受注済み装置に対する工事進行基準による売上高等の計上により、当セグメントの当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は、36億1千7百万円(前連結会計年度比4.9%減)となりました。

《その他》

当セグメントの当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は、5億5千5百万円(前連結会計年度比15.8%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期	当期						
		上半期			下半期		通期	
		第1Q	第2Q	第3Q	第4Q			
売上高	612,170	151,325	142,948	294,273	137,021	181,829	318,851	613,124
半導体製造装置	478,841	136,126	136,500	272,626	131,993	171,622	303,615	576,242
日本	76,424	13,421	26,084	39,505	19,081	29,160	48,241	87,747
米国	104,363	33,790	33,906	67,696	32,041	35,603	67,645	135,341
欧州	29,636	12,530	12,189	24,720	19,054	14,992	34,047	58,768
韓国	73,403	22,451	14,695	37,146	18,103	42,114	60,218	97,364
台湾	130,252	38,456	38,352	76,808	28,598	34,017	62,615	139,423
中国	48,897	13,911	7,069	20,981	6,322	12,409	18,732	39,713
東南アジア他	15,865	1,565	4,202	5,768	8,791	3,324	12,115	17,883
F P D製造装置	28,317	13,929	5,099	19,029	3,751	9,928	13,680	32,709
P V製造装置	3,805	1,102	1,223	2,325	1,146	145	1,292	3,617
電子部品・情報通信機器	100,726	-	-	-	-	-	-	-
その他	479	167	125	292	130	132	263	555
営業利益	32,204	17,069	13,045	30,115	22,081	35,916	57,997	88,113
経常利益	35,487	16,913	14,860	31,773	25,005	36,169	61,175	92,949
当期(四半期)純利益(△損失)	△19,408	11,835	8,181	20,016	17,451	34,420	51,871	71,888

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

④ 次期(平成28年3月期)の見通し

主力の半導体製造装置に関して、好調なモバイル需要とデータセンター向けサーバー需要を背景にメモリー向けを中心に設備投資が引き続き堅調に推移する見込みです。こうした事業環境を勘案し、次期(平成28年3月期)の連結業績見通しにつきましては、以下のとおり予想しております。

平成28年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通期
売上高	3,200億円 (前年同期比 8.7%増)	6,750億円 (前年同期比 10.1%増)
半導体製造装置	3,000億円 (前年同期比 10.0%増)	6,250億円 (前年同期比 8.5%増)
F P D製造装置	175億円 (前年同期比 8.0%減)	470億円 (前年同期比 43.7%増)
P V製造装置	25億円 (前年同期比 7.5%増)	30億円 (前年同期比 17.1%減)
その他	0億円	0億円
営業利益	470億円 (前年同期比 56.1%増)	1,120億円 (前年同期比 27.1%増)
経常利益	470億円 (前年同期比 47.9%増)	1,120億円 (前年同期比 20.5%増)
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益	330億円 (前年同期比 64.9%増)	790億円 (前年同期比 9.9%増)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

(2) 財政状態に関する分析

① 財政状態

当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ493億9千万円増加し、6,708億8千2百万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の増加264億9千9百万円、現金及び預金の増加230億3千6百万円、未収消費税等の増加93億7千6百万円、たな卸資産の増加73億1千1百万円、受取手形及び売掛金の減少181億8千6百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から54億4千7百万円減少し、1,068億9千6百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から19億8千9百万円減少し、275億6千6百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から56億8百万円増加し、708億7百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から475億6千2百万円増加し、8,761億5千3百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ23億2百万円増加し、1,728億1千2百万円となりました。主として、前受金の増加85億4千2百万円、賞与引当金の増加35億2千7百万円、未払費用の増加35億4百万円、支払手形及び買掛金の増加28億1千1百万円、未払消費税等の増加26億6千8百万円、東京エレクトロン デバイス(株)の連結除外による短期借入金の減少115億3千1百万円、未払法人税等の減少78億1千7百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ52億8千9百万円減少し、621億7千8百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ505億4千8百万円増加し、6,411億6千2百万円となりました。主として、当期純利益718億8千8百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当及び当期の第1四半期末配当、第2四半期末配当、第3四半期末配当179億2千3百万円の実施による減少、東京エレクトロン デバイス(株)の連結除外等による少数株主持分の減少106億2千万円によるものであります。この結果、自己資本比率は73.0%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ2,128億3千5百万円増加し、3,176億3千2百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ495億3千6百万円増加し、3,176億8千2百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前連結会計年度に比べ273億5千7百万円増加の718億6百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前当期純利益868億2千7百万円、減価償却費208億7千8百万円、前受金の増加129億1千1百万円、仕入債務の増加94億3千2百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加268億4千9百万円、法人税等の支払額242億3千9百万円、未収消費税等の増加113億8千3百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の減少による収入1,633億円、有形固定資産の取得による支出118億9千8百万円により、前連結会計年度の195億9千9百万円の支出に対し1,557億3千7百万円の収入となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払179億2千3百万円により、前連結会計年度の1億8千6百万円に対し182億1千3百万円となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成26年3月期	平成27年3月期
自己資本比率(%)	69.8	73.0
時価ベースの自己資本比率(%)	136.8	171.5
キャッシュ・フロー対有利子負債倍率(倍)	0.3	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	529.83	-

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債倍率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により計算しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社の配当政策は、業績連動型・収益対応型配当の継続実施であり、連結当期純利益に対する配当性向35%を目途とすることを株主還元の基本方針としております。

当社は、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し、成長分野に重点的に投資するとともに、業績連動型・収益対応型配当により、株主各位に対して直接還元してまいります。

なお、当期（平成27年3月期）につきましては、四半期配当を実施しておりますが、第4四半期末配当金につきましては、第4四半期の連結業績に上記方針を勘案し、1株当たり68円を予定しております。これにより、当期の1株当たりの配当金は、第1四半期末配当金10円、第2四半期末配当金30円、第3四半期末配当金35円を含め、年間配当金として143円となります。

また、次期（平成28年3月期）の配当に関しましては、前述の次期連結当期純利益見通しに上記方針を適用し、1株につき155円（中間配当65円、期末配当90円）の配当を予定しております。

当期 (平成27年3月期)	1株当たり配当金				年間
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末	
	10円	30円	35円	68円	143円
次期 (平成28年3月期)	中間		期末		年間
	65円		90円		

2. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、利益志向経営のもと、顧客第一主義、製品開発力・技術開発力の向上及び従業員の活性化に取り組むことによって、企業価値の向上を実現することを経営の基本方針としております。

こうした基本方針のもと、当社グループは、強い国際競争力、高い成長力、高い収益力を備え、活力あふれる力強い企業作りを推進し、当社株式が投資家各位にとって魅力あるものにしていきたいと考えております。

(2) 会社の対処すべき課題

当社グループは、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、技術革新の激しいエレクトロニクス産業のなかで、半導体及びFPD製造装置のリーディングサプライヤーとして、ビジネスを積極的に展開しております。

当社グループの属するエレクトロニクス・マーケットにおいては、高度なネットワーク社会の実現に向けて、半導体に求められる高速化、大容量化、低消費電力化、低コスト化などの技術要求は一層の高まりをみせております。技術や市場の転換点を迎えるなか、高度な技術開発力、顧客の課題を迅速に解決するサービス及び技術力、そしてグローバルに通用するコスト競争力が、技術イノベーションを支える当社グループの中長期的成長において重要との認識のもと、次の重点施策に注力すべきと考えております。

① 顧客の課題に応える製品力強化

既存参入分野において顧客が抱える課題を解決するためには、製品のプロセス性能に加え、生産性、信頼性、コスト競争力のさらなる向上が必要となります。当社グループといたしましては、エッチング装置、洗浄装置、コータ/デベロッパ、成膜装置など各プロダクトの技術競争力強化を図り、当社ポジションの向上に引き続き努めてまいります。

主力の半導体製造装置事業におきましては、なかでも市場成長が見込まれるエッチング装置に関して、今後重要となる3次元構造のNANDフラッシュメモリーやロジック・トランジスタ、また多重露光等の技術に対応する開発を引き続き強化し、事業拡大に取り組んでまいります。加えて、生産リードタイム短縮等の生産性改善に向けた活動及び品質改善等を積極的に実施し、コスト競争力の強化を図っております。また、洗浄装置事業につきましては、注力している枚葉ウェット洗浄装置とドライ洗浄装置の量産採用が進み、平成26年は過去最高のシェアを達成いたしました。微細化及び3次元化に伴う適用工程数の増加が見込まれるなか、今後も差別化された独自の技術を実現することで、一層の高収益、シェア獲得を目指してまいります。

FPD製造装置事業につきましては、拡大している低温ポリシリコンや酸化物半導体等の新材料を用いたディスプレイ市場に向け、最新のICP(誘導結合プラズマ)エッチング装置を投入し、収益拡大に取り組んでまいります。

なお、平成26年3月には、太陽光パネル製造装置事業の製造開発、販売活動から撤退し、半導体製造装置・FPD製造装置事業に経営資源を集中することといたしました。コアビジネスへの集中により、一層の利益率改善を図ってまいります。

② 継続的な成長のためのイノベーション(技術革新)

当社グループは、多様化する製造技術に対応するための新製品開発を引き続き強化し、次世代デバイスで要求される技術課題に対応すべく、装置の高精度化、信頼性向上に努めるとともに、デバイス製造コスト低減などの技術開発にも積極的に取り組んでおります。なかでも次世代メモリーとして注目を集めるMRAM(磁気メモリー)技術に関しましては、MRAM製造に必要な強磁場熱処理技術の開発も進み、当社グループの他の装置とのインテグレーションと合わせ、MRAM市場の立ち上がりに向けた量産技術の確立を目指しております。次世代デバイス技術に関しても、国内外の研究機関の知見を取り入れながら、積極的に開発に取り組んでおります。

また、有機ELパネルの分野におきましては、インクジェット方式の有機ELパネル製造装置を出荷いたしました。市場の本格的な立ち上がりに向けて、引き続き量産技術の検証を進めてまいります。

当期におきましては、テクノロジーセンター仙台で運営する事業を東京エレクトロン宮城(株)大和事業所(宮城県黒川郡大和町)へ移転するなど、開発拠点の集約を進めました。今後も、将来の有望技術を絞り込み、戦略的なリソースの集約と効率化による開発のスピードアップを図ることで、利益成長を追求してまいります。

③ ベスト・ソリューションの追求

当社グループは営業・サービス体制を充実させ、顧客の課題をスピーディーに解決すべく、ベスト・ソリューションの早期提供につなげるとともに、将来のニーズを早い段階から把握すべく顧客の近くで評価・開発を行うための体制を整える等、各顧客とのパートナーシップ強化に取り組んでおります。

また、テストシステムやアドバンスド・パッケージプロセスなどの後工程分野においても、引き続きコア技術を生かしたベスト・ソリューションを提供してまいります。

さらに、最新鋭装置の販売に加え、既に販売した装置の移設、改造、性能向上、パーツビジネス及び認定中古装置を手掛けるフィールドソリューション事業においても、世界中で稼働している当社の装置情報、フィールドで蓄積した知見の活用や、効果的かつ効率的に商品、サービスを提供する体制の構築により事業拡大に努めてまいります。

④ 企業の社会的責任としての取り組み

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値を創出することが、株主さま及び顧客、取引先、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さまに対する社会的責任であると考え、平成25年に制定したCSR方針のもと、専任組織を中心に重点課題を設定し、進捗のモニタリングを実施しております。

安全分野では、「Safety First(安全第一)」の理念に基づき、当社の従業員や経営者のみならず、顧客、取引先など当社の事業活動に関わるすべての人々の安全性向上及び健康増進に向けた改善に努めております。

環境分野では、「技術で環境問題に取り組む」という方針のもと、顧客工場での総合環境負荷低減を図るため、装置本体及び周辺機器のエネルギー使用量削減等の活動を進めるとともに、当社グループの事業活動や物流においても環境負荷低減活動を推進しております。

品質分野では、顧客に納入する製品について、品質強化の取り組みや重点課題などを設定し、国内、海外すべての製造拠点において品質方針を徹底し、当社グループ全体で品質向上と改善を推進しております。

調達活動においては、サプライチェーンにおける関連法規と社会規範の遵守、倫理及び公正な取引管理体制の強化を目指し、取引先とのコミュニケーションに努めております。

以上の重点施策に加え、成長の源泉となる人的資源に関しましては、ビジネス環境の急激な変化に対応できるよう、今後も適材適所の人材配置を実施し、能力開発プログラムの充実に積極的に取り組み、当社グループの飛躍につなげてまいります。また、貢献度に応じた公正な評価・報酬制度を整備し、夢と活力に満ちた会社を実現してまいります。

当社グループは、利益志向の経営のもと、顧客第一主義、製品開発力・技術開発力の向上、国際競争力の強化、従業員の活性化に取り組むことによって、今後も企業価値の向上を図ってまいります。

3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、現在、日本基準を適用して連結財務諸表を作成しており、また、アプライド マテリアルズとの経営統合に向けて、米国会計基準を適用するための準備を進めてまいりました。しかしながら、平成27年4月27日付「東京エレクトロン株式会社とApplied Materials, Inc. の経営統合契約の解約及びTELジャパン合同会社との株式交換の中止に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当該経営統合は実行されないこととなりました。今後の会計基準の選択に関しましては、国際財務報告基準(IFRS)の導入動向等に注視しつつ、適切に対応してまいります。

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	56,345	79,382
受取手形及び売掛金	129,032	110,845
有価証券	211,800	238,532
商品及び製品	114,289	112,301
仕掛品	38,074	41,483
原材料及び貯蔵品	15,912	21,803
繰延税金資産	25,173	27,671
その他	32,365	39,241
貸倒引当金	△1,502	△378
流動資産合計	621,492	670,882
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	151,633	152,979
減価償却累計額	△93,185	△97,910
建物及び構築物 (純額)	58,448	55,068
機械装置及び運搬具	97,055	102,295
減価償却累計額	△76,255	△82,420
機械装置及び運搬具 (純額)	20,800	19,874
土地	25,112	25,021
その他	34,989	32,539
減価償却累計額	△27,005	△25,608
その他 (純額)	7,983	6,931
有形固定資産合計	112,344	106,896
無形固定資産		
のれん	9,400	9,067
その他	20,155	18,499
無形固定資産合計	29,556	27,566
投資その他の資産		
投資有価証券	20,026	23,934
退職給付に係る資産	8,904	8,817
繰延税金資産	23,223	18,347
その他	14,911	21,591
貸倒引当金	△1,866	△1,884
投資その他の資産合計	65,199	70,807
固定資産合計	207,099	205,271
資産合計	828,591	876,153

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	53,667	56,478
短期借入金	11,531	-
賞与引当金	8,584	12,111
製品保証引当金	10,072	10,441
前受金	39,900	48,442
その他	46,753	45,337
流動負債合計	170,509	172,812
固定負債		
退職給付に係る負債	53,448	51,104
その他	14,019	11,074
固定負債合計	67,468	62,178
負債合計	237,978	234,991
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	436,174	488,816
自己株式	△9,478	△9,064
株主資本合計	559,679	612,736
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,592	9,463
繰延ヘッジ損益	60	122
為替換算調整勘定	5,777	12,481
退職給付に係る調整累計額	6,981	4,681
その他の包括利益累計額合計	18,411	26,747
新株予約権	1,643	1,420
少数株主持分	10,878	257
純資産合計	590,613	641,162
負債純資産合計	828,591	876,153

(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
売上高	612,170	613,124
売上原価	410,277	370,351
売上総利益	201,892	242,773
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	28,140	24,297
研究開発費	78,663	71,349
その他	62,882	59,013
販売費及び一般管理費合計	169,687	154,660
営業利益	32,204	88,113
営業外収益		
受取利息	1,343	901
為替差益	-	1,575
補助金収入	1,154	629
その他	2,975	1,880
営業外収益合計	5,473	4,985
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	47	47
コミットメントフィー	28	18
為替差損	1,229	-
投資有価証券評価損	230	-
その他	655	83
営業外費用合計	2,191	149
経常利益	35,487	92,949
特別利益		
固定資産売却益	433	1,839
その他	93	54
特別利益合計	526	1,894
特別損失		
減損損失	46,969	2,505
関係会社株式売却損	-	1,609
関係会社整理損	-	1,069
拠点再編費用	-	1,046
関税追加徴収額	-	1,003
その他	800	781
特別損失合計	47,769	8,015
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△11,756	86,827
法人税、住民税及び事業税	15,994	14,726
法人税等調整額	△8,537	172
法人税等合計	7,456	14,898
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	△19,213	71,928
少数株主利益	195	40
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,408	71,888

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	△19,213	71,928
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,365	3,868
繰延ヘッジ損益	91	69
為替換算調整勘定	6,867	6,642
退職給付に係る調整額	-	△2,269
持分法適用会社に対する持分相当額	-	56
その他の包括利益合計	8,324	8,366
包括利益	△10,888	80,295
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△11,150	80,224
少数株主に係る包括利益	261	70

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	54,961	78,023	467,920	△9,588	591,315
連結子会社の決算期変更に伴う増減額			△3,190		△3,190
当期変動額					
剰余金の配当			△9,138		△9,138
当期純損失(△)			△19,408		△19,408
自己株式の取得				△29	△29
自己株式の処分			△8	139	131
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	△28,555	110	△28,445
当期末残高	54,961	78,023	436,174	△9,478	559,679

	その他の包括利益累計額					新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	4,214	△14	△2,483	—	1,716	1,374	10,720	605,127
連結子会社の決算期変更に伴う増減額								△3,190
当期変動額								
剰余金の配当								△9,138
当期純損失(△)								△19,408
自己株式の取得								△29
自己株式の処分								131
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,378	74	8,260	6,981	16,695	269	157	17,122
当期変動額合計	1,378	74	8,260	6,981	16,695	269	157	△11,323
当期末残高	5,592	60	5,777	6,981	18,411	1,643	10,878	590,613

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	54,961	78,023	436,174	△9,478	559,679
会計方針の変更による 累積的影響額			△1,102		△1,102
会計方針の変更を反映し た当期首残高	54,961	78,023	435,072	△9,478	558,577
当期変動額					
剰余金の配当			△17,923		△17,923
当期純利益			71,888		71,888
自己株式の取得				△183	△183
自己株式の処分			△220	598	377
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	53,744	414	54,158
当期末残高	54,961	78,023	488,816	△9,064	612,736

	その他の包括利益累計額					新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計			
当期首残高	5,592	60	5,777	6,981	18,411	1,643	10,878	590,613
会計方針の変更による 累積的影響額							△210	△1,312
会計方針の変更を反映し た当期首残高	5,592	60	5,777	6,981	18,411	1,643	10,668	589,301
当期変動額								
剰余金の配当								△17,923
当期純利益								71,888
自己株式の取得								△183
自己株式の処分								377
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	3,870	62	6,703	△2,300	8,336	△223	△10,410	△2,297
当期変動額合計	3,870	62	6,703	△2,300	8,336	△223	△10,410	51,861
当期末残高	9,463	122	12,481	4,681	26,747	1,420	257	641,162

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△11,756	86,827
減価償却費	24,888	20,878
減損損失	46,969	2,505
のれん償却額	4,262	1,150
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	2,885	2,825
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△653	△1,601
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△228	△1,081
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,396	3,667
受取利息及び受取配当金	△3,161	△1,280
固定資産売却損益(△は益)	△303	△1,820
関係会社株式売却損益(△は益)	-	1,609
売上債権の増減額(△は増加)	△25,357	△1,318
たな卸資産の増減額(△は増加)	△32,088	△26,849
仕入債務の増減額(△は減少)	15,605	9,432
未収消費税等の増減額(△は増加)	△2,912	△11,383
未払消費税等の増減額(△は減少)	1,122	2,706
前受金の増減額(△は減少)	19,083	12,911
その他	3,301	△4,754
小計	43,052	94,424
利息及び配当金の受取額	3,222	1,621
利息の支払額	△83	-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△1,741	△24,239
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,449	71,806
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△98	-
定期預金の払戻による収入	9,871	5
短期投資の取得による支出	△192,515	△24,996
短期投資の償還による収入	174,200	188,296
有形固定資産の取得による支出	△9,451	△11,898
有形固定資産の売却による収入	896	2,548
無形固定資産の取得による支出	△1,640	△422
投資有価証券の売却による収入	111	1,093
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	1,726
その他	△972	△615
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,599	155,737
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	7,551	-
長期借入れによる収入	2,000	-
自己株式の純増減額(△は増加)	△29	△183
配当金の支払額	△9,138	△17,923
その他	△569	△106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△186	△18,213
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,973	3,505
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	20,690	212,835
現金及び現金同等物の期首残高	85,313	104,797
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,206	-
現金及び現金同等物の期末残高	104,797	317,632

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

会計方針の変更

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

なお、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響は、軽微であります。

(セグメント情報)

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」及び「PV(太陽光パネル)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「PV製造装置」は、薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造・販売・保守サービス等を行っていましたが、平成26年3月末をもって新規装置の製造開発、販売活動を停止し、納入済み装置に対するサポートのみを行っております。

② 報告セグメントの変更等に関する事項

当社の連結子会社でありました東京エレクトロン デバイス(株)が持分法適用関連会社へ異動したことに伴い、当連結会計年度より、同社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外し、同社に係る持分法投資損益はセグメント利益又は損失の調整額に含めております。

③ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。また、共用資産については、各報告セグメントに配分してはおりませんが、関連する費用については、合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分してはおります。

④ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度(自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	F P D 製造装置	P V 製造装置				
売上高							
外部顧客への 売上高	576,242	32,709	3,617	555	613,124	-	613,124
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	-	-	-	11,442	11,442	△11,442	-
計	576,242	32,709	3,617	11,997	624,567	△11,442	613,124
セグメント利益 又は損失(△)	135,991	△1,312	△8,789	1,169	127,059	△40,231	86,827
セグメント資産	305,582	23,750	1,731	1,891	332,956	543,197	876,153
その他の項目							
減価償却費	10,017	426	5	42	10,492	10,385	20,878
のれんの償却額	1,150	-	-	-	1,150	-	1,150
減損損失	387	509	-	-	896	1,609	2,505
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	8,529	197	-	23	8,750	5,530	14,280

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等であります。
2. 調整額の主な内容は、以下のとおりであります。
- (1) セグメント利益又は損失の調整額△40,231 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△17,108 百万円及び、経営統合に係る費用△8,529 百万円等であります。
- (2) セグメント資産の調整額 543,197 百万円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない現金及び預金、有価証券、建物及び構築物等であります。
- (3) 減損損失の調整額 1,609 百万円は、各報告セグメントに配分していない建物及び構築物等に係るものであります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 5,530 百万円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない建物及び構築物、機械装置及び運搬具の設備投資額であります。
3. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

⑤ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

「④ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報」を参照ください。

⑥ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当連結会計年度(自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

	半導体製造装置	F P D 製造装置	P V 製造装置	合計
当期償却額	1,150	-	-	1,150
当期末残高	9,067	-	-	9,067

⑦ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(1 株当たり情報)

項 目	当連結会計年度 (自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額	3,567 円 23 銭
1 株当たり当期純利益	401 円 08 銭
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	400 円 15 銭

(注) 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1 株当たり当期純利益	
当期純利益 (百万円)	71,888
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—
普通株式に係る当期純利益 (百万円)	71,888
普通株式の期中平均株式数 (千株)	179,238
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
当期純利益調整額 (百万円)	—
普通株式増加数 (千株) 新株予約権	413
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	—

(重要な後発事象)

当社は、アプライド マテリアルズとの経営統合に関し、平成 25 年 9 月 24 日付にてアプライド マテリアルズとの間で経営統合契約を締結するとともに、平成 26 年 5 月 14 日付で TEL ジャパン合同会社との間で株式交換契約を締結しておりましたが、平成 27 年 4 月 27 日付「東京エレクトロン株式会社と Applied Materials, Inc.の経営統合契約の解約及び TEL ジャパン合同会社との株式交換の中止に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、平成 27 年 4 月 27 日開催の取締役会において当該統合契約を解約し、TEL ジャパン合同会社との三角株式交換を中止することを決議いたしました。

なお、本件による当社の財政状態及び経営成績に与える重要な影響はありません。

5. その他

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 〔 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 〕	当連結会計年度 〔 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 〕
	生産高	生産高
半 導 体 製 造 装 置	470,086	559,926
F P D 製 造 装 置	36,047	33,230
P V 製 造 装 置	3,876	3,488
合 計	510,010	596,645

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 〔 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 〕		当連結会計年度 〔 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	546,932	209,914	626,795	260,467
F P D 製 造 装 置	41,336	29,019	35,301	31,611
P V 製 造 装 置	4,303	8,994	△1,684	3,692
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	103,141	17,200	—	—
そ の 他	479	—	555	—
合 計	696,194	265,129	660,967	295,771

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 〔 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 〕	当連結会計年度 〔 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 〕
	販売高	販売高
半 導 体 製 造 装 置	478,841	576,242
F P D 製 造 装 置	28,317	32,709
P V 製 造 装 置	3,805	3,617
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	100,726	—
そ の 他	479	555
合 計	612,170	613,124

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。